

ЭТИКЕТКА

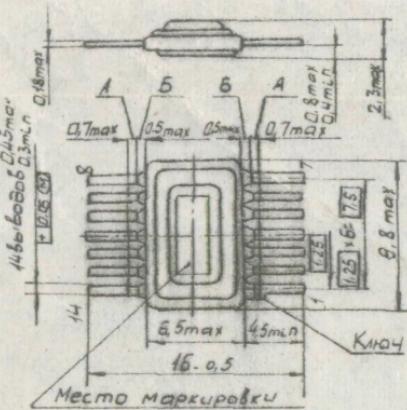
МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ТИПОВ :
ОС149КТ1А, ОС149КТ1Б, ОС149КТ1В

3.426.000СЧТУ

Партия (извещение) № 788

Основное назначение: Переключение электрических сигналов.

Габариты :



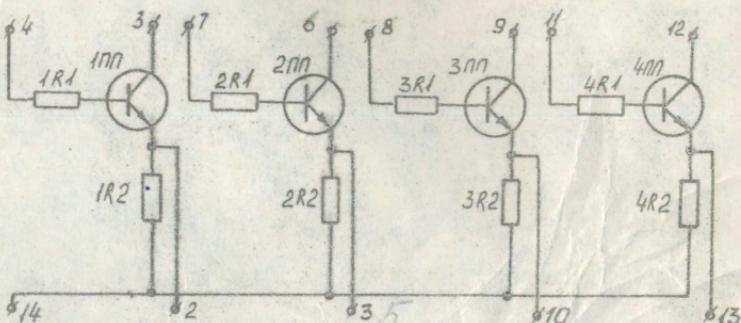
А-зона вывода, в пределах которой установлены смещение плоскостей симметрии выводов и предельное отклонение размера, определяющего место выхода вывода, от номинального расположения.

Б-длина вывода, непригодная для монтажа. Допускаются наплыны стекла по выводам за пределы наружного контура корпуса микросхемы не более 0,5мм на сторону. Нумерация выводов показана условно. Допускаются заусенцы высотой 0,04мм шаг, сверх размера 0,18мм.

Форма ключа не регламентируется.

Дно металлическое.

Электрическая схема.



Масса микросхемы не более 0,35 г.

В одной микросхеме содержится 25,8301мг золота, 1,1016мг серебра.

I. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ В ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР

- выходное напряжение открытой схемы $U_{\text{вых}}^0 \leq 0,7 \text{ В}$;
- время задержки включения $t_{\text{з.вкл}} \leq 150 \text{ нс}$;
- время задержки выключения $t_{\text{з.выкл}} \leq 450 \text{ нс}$;
- выходной ток каждого ключа закрытой схемы $I_{\text{вых}}^0 \leq 20 \text{ мА}$;
- входное напряжение открытой схемы $U_{\text{вх}}^0 \leq 2,7 \text{ В}$ при $I_{\text{вх}} = 10 \text{ мА}$ и $T = -60^\circ\text{C}$; $U_{\text{вх}}^0 \leq 1,6 \text{ В}$ при $I_{\text{вх}} = 4 \text{ мА}$, $T = +25^\circ\text{C}$; $U_{\text{вх}}^0 = 0,85 + I_{\text{вх}}$ при $I_{\text{вх}} = 4 \text{ мА}$, $T = +125^\circ\text{C}$.

2. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ:

- напряжение питания, Е OC149KTIA = $3 \pm 0,3 \text{ В}$
OC149KTIB = $5 \pm 0,5 \text{ В}$
OC149KTIB = $12,6 \pm 1,26 \text{ В}$;
 - наибольшее входное обратное напряжение $U_{\text{вх.обр.}} = -4 \text{ В}$;
 - наибольший входной ток $I_{\text{вх}} = 50 \text{ мА}$;
 - мощность, рассеиваемая на корпусе в диапазоне температур от минус 60°C до $+25^\circ\text{C}$, $P_K = 0,4 \text{ Вт}$. В интервале температур окружающей среды от $+25^\circ\text{C}$ до $+125^\circ\text{C}$ P_K определяется по формуле:

$$P_K = 0,1 + \frac{125 - T_{\text{окр.}}}{R_t} (\text{Вт})$$
- $R_t = 330^\circ\text{C}/\text{Вт}$;
- ток переключения $I_{\text{пер}} \leq 200 \text{ мА}$;
 - диапазон рабочих температур окружающей среды от минус 60°C до $+125^\circ\text{C}$.

3. Время минимальной наработки - 15000 часов.

4. Срок сохраняемости - 15 лет.

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- a) микросхемы, выпускаемые по З.426.000СЧТУ, должны применяться и эксплуатироваться в строгом соответствии с требованиями З.426.000СЧТУ, разделом 5 ОСТ ВИ.073.012-74 и руководством по применению ОСТ ИБКО.3421009-72, высылаемым головным предприятием по применению микросхем по запросам предприятий-потребителей;
- b) при наработке микросхем в течение 30000 часов должны обеспечиваться условия эксплуатации при $\text{t} = 25^{\circ} \pm 10^{\circ}\text{C}$ и снижение электрических, климатических и механических нагрузок относительно номинальных не менее чем на 30%;
- v) при работе с микросхемами и монтаже их в аппаратуру должны быть приняты меры по защите их от воздействия электростатических зарядов с величиной потенциала более 80 В.

Для устранения влияния электростатических зарядов на микросхемы необходимо иметь инструкцию, предусматривающую меры по уменьшению аккумуляции электростатических зарядов, согласованную с головным предприятием по применению микросхем:

- г) при формовке выводов величина растягивающего усилия, направленного вдоль оси вывода, не должна превышать 0,12 кгс. Разрешается только однократная формовка выводов;
- д) разрешается только одноразовая пайка микросхем на плату.

Допускается двухразовая пайка не более 5 выводов микросхем⁴,

- е) корпуса микросхем должны устанавливаться на печатную плату вплотную по всей поверхности дна корпуса с помощью клея, вывода зацеплять методом распайивания. При приклейке должно соблюдаться равномерно воздействующее усилие прижатия корпуса не более 0,5 кг. Не допускается воздействие крутящих и изгибающих моментов;
- ж) запрещается кручение выводов микросхем вокруг оси и изгиб выводов в плоскости корпусов микросхем;
- з) при монтаже микросхем на плату, имеющую токопроводящие дорожки под микросхемой, допускается прокладывать изолирующий слой, сохраняющий изолирующие свойства в диапазоне температур;
- и) микросхемы в блоках аппаратуры рекомендуется покрыть лаком (например УР-231 или ЭП-730), обеспечивающим лучшую работоспособность микросхем в условиях повышенной влажности, морского тумана, инея и росы.

Количество слоёв при покрытии лаком - не менее 3;

- к) способ установки схем на платы и демонтаж схем должен обеспечивать отсутствие усилий, деформирующих корпус (или приводящих к деформации корпуса).

27 = 777.

ОТК 335 *

ШТАМП П.З.

ШТАМП ОТК

51